第 59 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2026 年 11 月 16 日（月）13:00～16:35

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会　高尾　尚史（トヨタ自動車株式会社）

13:00～13:10　委員会議事

13:10～13:50

『生物の神経系に学ぶニューロモルフィック集積回路 ― AI・ロボットへの応用と展望』(40 分)

……○齊藤　健（日本大学理工学部）

13:50～14:30

『次世代パワー半導体を支える TLP 接合技術～Ni-Sn 系 IMC 形成と高耐熱・高信頼性接合～』（40 分）

……○立花芳恵（千住金属工業株式会社）

14:30～15:00

『パワー半導体用　低熱膨張高熱伝導クラッド材の開発』（30 分）

……○山本雄一郎（株式会社プロテリアル金属）

15:00～15:15　休 憩

司会　森　貴裕（株式会社 ADEKA）

15:15～15:55

『大面積・微細ピッチガラスコア上の階層型インターコネクトを用いた省エネルギーAI–CPO パッケージ』（40 分）

……○倉持　悟（大日本印刷株式会社）

15:55～16:35

『TGV ガラスにおける洗浄の課題と洗浄効果』（40 分）

……○西座弘明氏（株式会社パーカーコーポレーション）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会　エレクトロニクス生産科学部会